

FrameScanPlus 0.425 × 0.575 inch OTC-TD-FS-SP-015-011

产品 14764



直接訪問產品

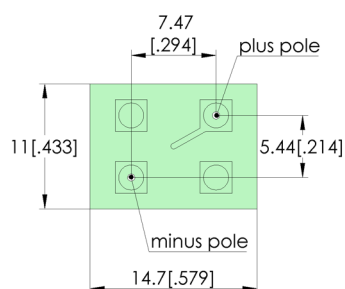
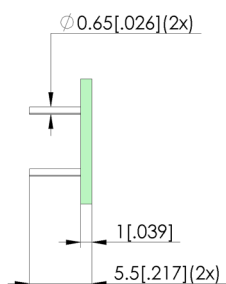
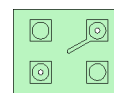
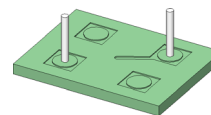
ingun®

Partner for Future Technology

- 开路测试用组件, 用于半导体芯片的电容式测试, 检测其是否断裂、短路和存在焊接缺陷
- 适用于 Teradyne 测试系统

使用

FrameScan Plus 传感器板用于集成电路的电容测试, 可检查集成电路内部的接线接口是否存在断裂、短路和缺陷焊接。



一般数据

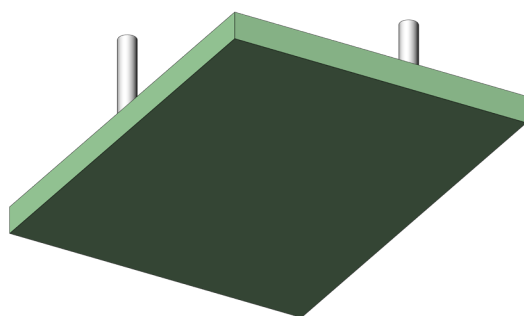
产品组:	开路测试
结构系列:	OTC
类型:	Teradyne opens test
规格:	
配件类型:	扩展配件
交付状态:	传感器板 015-011
宽度:	11 mm
高度:	5,5 mm
重量:	0,01 kg
最小温度:	10 °C
最大温度:	60 °C
RoHS 符合性:	是

适用于

真空测试治具 (VA): VA 20xx
替换套件 (WS): 替换套件 Teradyne/TSH5x

技术数据

长度: 14,7 mm
外部尺寸 (宽x深x高): 14,7 x 11 x 5,5 mm



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。04/26_CN